

证券简称：灿芯股份

证券代码：688691

## 灿芯半导体（上海）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	德邦证券、中邮证券
时间	2024年11月6日
地点	公司会议室
上市公司 接待人员姓名	董事会秘书沈文萍女士及董办工作人员石啸天、梁砚卿
投资者关系 活动主要内容 介绍	<p>公司情况简要介绍：</p> <p>灿芯股份是一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。公司定位于新一代信息技术领域，自成立至今一直致力于为客户提供高价值、差异化的芯片设计服务，并以此研发形成了以大型 SoC 定制设计技术与半导体 IP 开发技术为核心的全方位技术服务体系。</p> <p>依托完善的技术体系与全面的设计服务能力，公司不断帮助客户高质量、高效率、低成本、低风险地完成芯片设计开发与量产上市。公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。</p> <p>2024年1-9月，公司共实现营业收入8.63亿元，同比下降14.16%，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,197万元，同比下降41.76%。其中第三季度，公司实现营业收入2.69亿元，同比下降20.51%。</p> <p>投资者提出的主要问题及公司回复情况如下：</p> <p>1、公司目前一站式芯片定制服务的下游应用领域及客户群体主要有哪些？</p>

答：公司为客户提供芯片设计服务最终转化为客户品牌的芯片产品被广泛应用于物联网、工业控制、消费电子、网络通信、智慧城市、高性能计算等行业。就客户群体而言，公司下游客户主要为系统厂商和芯片设计公司，系统厂商是指面向终端应用提供整机系统设备的厂商；芯片设计公司是指从事自有品牌芯片产品设计研发及销售的企业。

## 2、公司目前在 IP 研发方面的研发方向及进展情况？

答：公司目前聚焦在高速接口 IP 及高性能模拟 IP 的研发方面。高速接口 IP 方面，公司致力于提升公司 DDR、Serdes、PCIe、MIPI、USB、ONFI、APHY、以太网 PHY 等接口 IP 在速率、带宽、功耗等关键性能的持续提升与优化，可满足数据中心、智慧城市等应用领域对于高效互联的需求；高性能模拟 IP 方面，公司致力于实现公司主要模拟 IP 在转换精度、面积、功耗等关键性能的持续提升与优化，可满足物联网、工业控制、网络通讯、医疗等众多应用领域的数据采集及存储需求。

## 3、公司目前的研发投入及未来研发规划是怎样的？

答：基于公司长远发展考虑，公司本年度扩大研发团队规模、持续加大研发投入，2024 年前三季度研发投入为 1.11 亿元，同比增长 47.56%。公司未来将根据自身战略进行研发布局，始终重视研发投入及研发团队建设，持续提高公司竞争力。

## 4、公司如何看待自身的竞争优势？

答：公司的竞争优势主要包括以下几方面：（1）优秀的芯片设计能力与丰富的芯片定制经验优势；（2）可满足客户多样化需求的技术服务能力；（3）与中国大陆最领先晶圆厂战略合作的优势；（4）技术人才与团队优势；（5）多行业芯片定制服务经验与持续研发能力优势；（6）受到客户广泛认可。

## 5、公司 2024 年前三季度主要财务数据变动的的原因？

答：研发投入方面，公司基于长远发展考虑，扩大研发团队规模，持续加大研发投入，导致研发投入金额增长。归属于上市公司股东的净利润方面，2024 年前三季度，公司受下游客户需求波动影响收入同比下滑，同时前三季度研发投入较去年同期增长较大。经营活动产生的现金流量净额方面，公司 2024 年前三季度经营活动产生的现金流量净额减少，一方面系

	<p>收入波动导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，另一方面系公司虽购买商品、接受劳务支付的现金随收入波动减少，但公司支付的员工薪酬及经营相关税费增多，从而共同导致公司 2024 年前三季度经营活动产生的现金流量净额下降。</p> <p>6、公司对未来发展有什么展望？</p> <p>答：公司将继续专注于为客户提供一站式芯片定制服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。凭借成熟的行业应用解决方案、优秀的芯片架构设计能力和丰富的芯片设计经验，帮助客户高效率、高质量完成芯片的定义、设计和量产出货。未来，公司将继续坚持技术创新进步，加强对新技术的研发，不断深耕对不同工艺制程的研究，助力半导体产业的蓬勃发展。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 6 日
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无